

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010年2月11日(11.02.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/016223 A1

- (51) 国際特許分類:
B29C 43/18 (2006.01) B29C 43/36 (2006.01)
B29C 43/32 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
B29C 43/34 (2006.01) B29L 31/34 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/003683
- (22) 国際出願日: 2009年8月3日(03.08.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-205018 2008年8月8日(08.08.2008) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): TOWA 株式会社(TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 浦上浩 (URAGAMI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 高田直毅(TAKADA, Naoki) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 大槻修 (OTSUKI, Osamu) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市

南区上鳥羽上調子町5番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP).

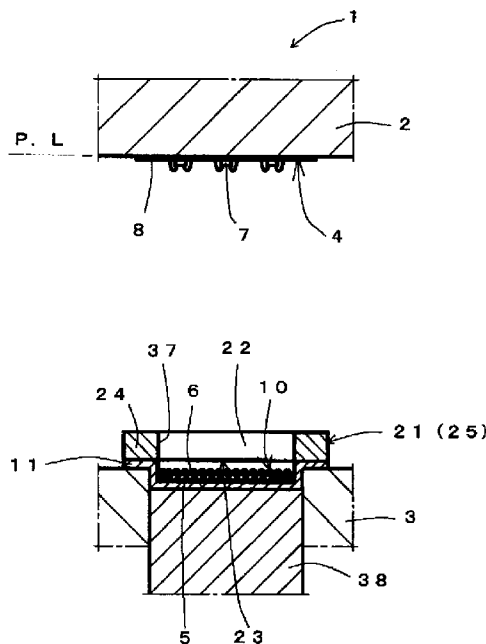
- (74) 代理人: 特許業務法人京都国際特許事務所(KYOTO INTERNATIONAL PATENT LAW OFFICE); 〒6008091 京都府京都市下京区東洞院通四条下ル元恵王子町37番地 豊元四条烏丸ビル Kyoto (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR COMPRESSION-MOLDING ELECTRONIC COMPONENT AND DIE APPARATUS

(54) 発明の名称: 電子部品の圧縮成形方法及び金型装置

[図4]



(57) Abstract: A resin supply pre-plate (21a) is configured by forming an opening section (37) on a resin-storing section (22) by applying a die-releasing film (11) on a lower surface of a resin-storing plate (21) having the opening section (37) corresponding to a lower die cavity (5) so as to efficiently improve reliability of a resin quantity supplied into the lower cavity (5) at the time of supplying a granular resin (6) into the lower die cavity (5). A resin-dispersed plate (25) is formed by supplying the resin-storing section (22) with the granular resin (6) of a required quantity and flattening the resin (i.e., forming the resin in uniform thickness). Then, by placing the resin-dispersed plate (25) at a position of the lower die cavity (5) and pulling the die-releasing film (11) into the lower die cavity (5), the flattened granular resin (6) of a required quantity is dropped together with the die-releasing film (11) and is supplied into the cavity (5) covered with the die-releasing film (11).

(57) 要約: 下型キャビティ5内への顆粒樹脂6の供給時において、下型キャビティ5内に供給される樹脂量の信頼性を効率良く向上させるために、下型キャビティ5に対応した開口部37を備えた樹脂収容用プレート21の下面に離型フィルム11を被覆して開口部37を樹脂収容部22に形成して樹脂供給前プレート21aを構成すると共に、樹脂収容部22に所要量の顆粒樹脂6を供給して平坦化する(均一な厚さに形成する)ことにより樹脂分散済プレート25を形成し、次に、樹脂分散済プレート25を下型キャビティ5の位置に載置して離型フィルム11を下型キャビティ5内に引き込むことにより、離型フィルム11と一緒に所要量の平坦化した顆粒樹脂6を落下させて離型フィルム11を被覆したキャビティ5内に供給する。

WO 2010/016223 A1



NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, 添付公開書類:

CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
TD, TG).